

Lagebericht zur Entwicklung der Beschaffungsmarktsituation VIII

Einsiedeln, 26.01.2023

Sehr geehrte Kunden

Es ist eine lange Zeit vergangen, seit wir unseren letzten Lagebericht an Sie verschickt haben. Der Grund ist relativ einfach: Die Marktbedingungen haben sich aus unserer Sicht nicht verbessert. Im Gegenteil, die Komplexität der Prognostizierbarkeit hat sich aufgrund der Situation in der Ukraine, der Euro-Krise, der Inflation und einer möglichen Rezession sowie dem chinesischen Neujahrsfest im Verbund mit den lokalen Corona-Begebenheiten erheblich erschwert. Vor Kurzem ist zudem ein Grossbrand in einer Fertigung eines unabhängigen Dienstleisters in Wuxi bekannt geworden, in der Wafer (Vormaterial von ICs) für viele namhafte Hersteller beschichtet werden.

Lagebeurteilung

Wir sehen die derzeitige Situation als stagnierend mit einer leichten Tendenz einer möglichen Entspannung in einigen Segmenten. Da Ihre Produkte, seien dies bestückte Baugruppen oder ganze Geräte, aber meist aus dutzenden oder mehr Rohmaterialien bestehen, wird selbst eine teilweise Entspannung keine positiven Auswirkungen auf die Wiederbeschaffungszeit ausmachen. Nebst der Ist-Situation sehen wir zusätzlich aufkommende Risiken.

Eines der übergeordneten Risiken ist die **Inflation und der wirtschaftliche Abschwung**. Die Inflation wird 2023 tendenziell kaum abschwächen, sondern sich eher fortsetzen. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass viele Volkswirtschaften stagnieren oder schrumpfen werden. Zahlungs- wie Finanzierungsprobleme sind daher möglich und sollten nicht ausgeschlossen werden.

Auch die **Sicherung der Lieferketten** ist ein zentrales Thema. Die Herausforderungen begannen mit den Covid-bedingten Rückständen und wurden durch den Einmarsch von Russland in die Ukraine sowie dem Arbeitskräftemangel infolge der grossen Resignation noch verschärft. Dies hat die Beschaffung von Teilen und Produkten erschwert und die Preise verschiedenster Güter in die Höhe getrieben.

Ein weiteres Risiko ist die **Unterbrechung der Produktionen** aufgrund «Chinese New Year». Leider werden die Fabriksschliessungen in China im aktuellen Jahr wahrscheinlich schlimmer ausfallen als in den Vorjahren, da die Zahl der Covid-19-Fälle nach der Aufhebung der Beschränkungen und der verordneten Schliessungen steigt. Es ist mit weit längeren Produktionsausfällen als bei einer regulären Dauer des Neujahrsfestes zu rechnen.

Auch **Qualitätsprobleme** können aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes auftreten. Es ist davon auszugehen, dass ein relevanter Anteil der Fabrikarbeiter nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt. Infolgedessen werden viele unerfahrene Arbeiter befördert oder neu eingestellt, von Fließbandarbeitern über Manager bis zu den verschiedensten Fachkräften.

Die neuste Unbekannte ist der oben erwähnte **Grossbrand in Wuxi** in einer Fertigung, wo der sogenannte «Plating» Prozess von Wafern gemacht wird. Die genauen Folgen sind aktuell noch schwer abzuschätzen. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist mit erheblichen Auswirkungen in den nachfolgenden Herstellprozessen und somit von verschiedenen ICs (vermutlich Gehäuseformen SOTx, SOD323, SC7x, TSFP, TSSOP10, SS08, Mini FP und DSC P12) zu rechnen. Nach Angaben von Infineon ist die spezielle und komplexe Infrastruktur schwer beschädigt.

Auswirkungen

Zusammenfassend kann man sagen, dass trotz gegenteiliger Schlagzeilen ein Ende der weltweiten Halbleiterknappheit nicht in Sicht ist. Die beschriebene Situation führt zu einer angespannten Lage im Angebot. Gleichzeitig war die Nachfrage nach Halbleitern noch nie so hoch wie heute.

Die anhaltende Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage führt folglich dazu, dass die Vorlaufzeiten immer länger werden. Im Grunde gibt es keine Wartezeiten von weniger als 30 Wochen. Seit Sommer 2022 betragen die Vorlaufzeiten für die meisten Halbleiter (unabhängig vom Typ) mindestens 40 bis 50 Wochen, bei vielen sogar 50 bis über 60 Wochen.

Auf der Grundlage von Marktdaten und Gesprächen mit unseren Lieferanten sowie Kunden gehen wir davon aus, dass der Markt für Basis-Halbleiter bis Ende des Jahres 2023 angespannt bleiben wird. Der Markt für komplexe Halbleiter – Mikrocontroller, Mikroprozessoren und FPGAs, um nur einige zu nennen – wird bis sicher Frühjahr 2024 angespannt bleiben.

Handlungsempfehlungen

Um sicherzustellen, dass Sie in einer anhaltenden Chipknappheit in der bestmöglichen Position sind, empfehlen wir Ihnen folgende Massnahmen zu ergreifen:

- **Verbindlichkeit:** Stellen Sie uns Rahmenkontrakte, Bestellungen und/oder verbindliche Planzahlen für den Zeitraum bis Sommer 2024 zur Verfügung. Dies ermöglicht uns eine bessere Planbarkeit und erleichtert die Materialbeschaffung.
- **Sichtbarkeit:** Bieten Sie uns so viel Transparenz wie möglich, damit nicht nur die Materialbeschaffung, sondern auch Produktionskapazitäten und mögliche längerfristige Investitionen geplant werden können.
- **Vorlaufzeiten und gepufferte Bestände:** Einige Zulieferer von uns benötigen eine Sichtbarkeit von 12 bis 24 Monaten. Hinterlegen Sie, wenn möglich, einen validen Sicherheitsbestand, um nicht vorhersehbare Risiken abzufedern (siehe Grossbrand Wuxi). Die Wiederbeschaffungszeit Ihrer Elektronikgeräte/PCBAs sollte mindestens 40 Wochen betragen, bei Spezialitäten oder High-End-Komponenten sogar über 60 Wochen.
- **Neuprodukte:** Starten Sie frühzeitig mit Produktentwicklungen und planen Sie parallel dazu die Materialbeschaffung sämtlicher Materialien, um einen reibungslosen Marktklaunch zu gewährleisten und evaluieren Sie so viele Alternativ-Typen bei Bauteilen, wie möglich, um die Supply-Chain flexibler und damit schneller zu machen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Lage weiterhin schwierig bleiben wird und dass es keine schnelle Lösung gibt. Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um die Auswirkungen dieser angespannten Marktsituation auf unsere Produktion und Lieferfähigkeit so gering wie möglich zu halten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, falls es zu Verzögerungen oder Engpässen kommen sollte.

Danke an dieser Stelle für das Vertrauen und die gute Partnerschaft! Durch Ihr aktives Mitwirken und Agieren gemäss unseren Handlungsempfehlungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag, dass wir weiterhin eine termingerechte Produktion und Lieferung ermöglichen können und beide Parteien gestärkt in die Zukunft gehen.

Sollten Sie ein gemeinsames Meeting zur Beurteilung der Marktsituation und Besprechung der daraus notwendigen Schritte wünschen, nehmen Sie bitte mit unserem Sales-Team Kontakt auf.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

STEINEL Solutions AG
Ihr Sales-Team

Anlagen/ Verweise

- Z2Data Insights: «Fire in Wuxi» [Link zum Artikel](#) (EN, 20.01.2023)
- Elektroniknet.de: «Engpässe bleiben, aber 2023 wandelt sich der Markt»: [Link zum Artikel](#) (19.01.2023)
- Infineon Technologies AG: «Business Continuity Customer Notification-Fire incident at manufacturing partner in Wuxi (China).pdf»: N° 2023-0 (EN, 12./19.01.2023)
- Infineon Technologies AG: «Fire incident at manufacturing partner in Wuxi (China)-Current status and way forward.pdf» (EN, 12.01.2023)
- Vishay: «Advisory – Product Delivery Interruption UPDATE.pdf» (EN 13.01.2023)
- FusionWorldwide: « Shortages for NXP and STM persist into the new year»: [Link zum Artikel](#) (EN, 01/2023)
- Eletronikpraxis: «Rückblick 2022-Ukrainekrieg treibt Wirtschaft ins Chaos»: [Link zum Artikel](#) (06.01.2023)
- Elektroniknet.de: «Besserung bei Lieferketten-Industrie-Abschwung im Dezember verlangsamt»: [Link zum Artikel](#) (04.01.2023)

Auf Wunsch stellen wir unseren Kunden ein Dossier von diversen Informationsschreiben unserer Lieferanten zu.

Frühere Lageberichte finden Sie auf unserer Website im [Media Room](#) unter «Lageberichte & Kundeninformation».